



## Stainer ST

### Klej do styropianu

- Wydajność 8 – 12m<sup>2</sup> z tuby
- Szybka i czysta aplikacja
- Temperatura stosowania – 5 do + 30°C

#### OPIS PRODUKTU

STAINER ST to niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczony jest do mocowania płyt styropianowych EPS oraz płyt XPS przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków, piwnic itp.

#### ZASTOSOWANIE

Klej poliuretanowy STAINER ST służy do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową (ETICS), kasetonów styropianowych, paneli ściennych, montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej. Klej można zastosować w systemach ociepleń przyziemi (fundamentów) z użyciem płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz z zastosowaniem płyt polistyrenu ekspandowanego (EPS). Klej poliuretanowy wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża betonowych, ceramicznych, drewnianych a także do PVC oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków oraz podłoży z powłoką bitumiczną, papy i asfaltowych mas izolacyjnych. Klej poliuretanowy można również stosować do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoża betonowych. Po 2 godzinach od przyklejenia uzyskuje się utwardzenie wstępne pozwalające na kontynuację prac związanych z szlifowaniem i kółkowaniem płyt lub zabezpieczeniem przyziemi, a pełne utwardzenie spoiny poliuretanowej uzyskiwane jest po 24 h.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

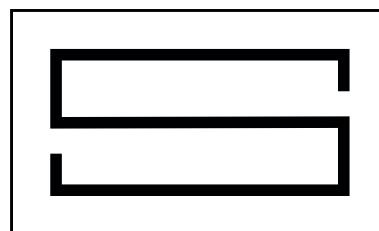
Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych zanieczyszczeń (w szczególności środków antyadhezyjnych), które mogą spowodować brak odpowiedniej przyczepności kleju do podłoża. Należy sprawdzić przyczepność istniejących powłok, tynków, warstw bitumicznych, a odspojone warstwy podłoża należy usunąć. Przed przystąpieniem do mocowania płyt styropianowych w niskich temperaturach z podłoża należy usunąć szron, a zacieki wodne osuszyć, a puszkę kleju należy ogrzać do temperatury pokojowej (dokonać można tego zanurzając puszkę np. w ciepłej wodzie), a następnie intensywnie wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Puszkę przykręcić do pistoletu aplikacyjnego i dozować w pozycji roboczej „do góry dnem”. Regulację strumienia kleju dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku przerwy w aplikacji powyżej 15 minut pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia. W przypadku podłoża z powłoką bitumiczną (o nieznanach parametrach) warto przeprowadzić próbę przyczepności tj. płytę z naniesionym klejem poliuretanowym przykleić do przygotowanego wcześniej fragmentu podłoża, a następnie po około min. 2 h wykonać próbę zerwania połączenia klejowego. Podłoże bitumiczne musi być wysezonowane, dobrze związane, wilgoć odparowana z całej grubości powłoki.

W systemach termoizolacji ETICS przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy zamocować listwy startowe, a w systemach izolacji fundamentów w celu uzyskania stabilnego podparcia dla klejonych płyt termoizolacyjnych, należy je wesprzeć na stopie fundamentowej, a jeśli to możliwe podeprzeć je w trakcie wiązania. Płyty izolacyjne hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszliować np. papierem ściernym.

#### SPOSÓB UŻYCIA

##### Mocowanie płyt styropianowych w systemach ETICS:

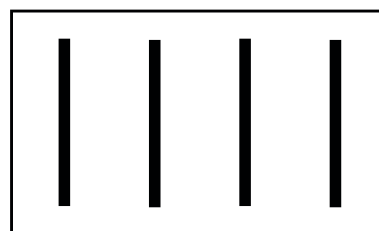
Klej do styropianu nakładamy warkoczem o średnicy ok 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krawędzi ok 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Powierzchnia klejenia nie powinna być mniejsza niż 40%. W celu uniknięcia powstania „poduszki powietrznej” w środkowej części płyty, należy zachować 5 cm przerwy w pasmach kleju, nakładanych na przeciwległych krawędziach płyty, jak przedstawiono na rysunku poniżej:



Grubość utworzonej spoiny powinna wynosić (po przyłożeniu płyty do podłoża) 8 lub 15 mm. Po nałożeniu pasów kleju należy odczekać ok. 3 minut (temp. 20°C) lub 5 minut (temp. – 5°C), a następnie przyłożyć do izolowanej ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łąty montażowej. Ustawienie klejonych płyt można dokonać do 4 minut od przyklejenia do izolowanej powierzchni. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki (szlifowanie i kółkowanie). Szczeliny i złącza pomiędzy klejonymi płytami wypełnić klejem. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć środkiem do czyszczenia np. czyścik. Prac z użyciem kleju nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych oraz silnego nasłonecznienia.

##### Mocowanie termoizolacji do fundamentów:

Klej na płytę nakładamy 4 pionowymi warkoczami o średnicy ok 3 cm z zachowaniem równych odstępów co 20 – 30 cm pomiędzy pasami oraz pozostawić 3 cm odstępu od krawędzi płyty (w przypadku płyt o szerokości powyżej 100 cm, należy nałożyć na powierzchnię płyty większą ilość warkoczy kleju). Ogólny schemat postępowania przedstawiony został na rysunku poniżej:



Po nałożeniu pasów kleju należy odczekać ok. 3 minut (temp. 20°C) lub 5 minut (temp. – 5°C), a następnie przyłożyć do izolowanej ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łąty montażowej. Ustawienie klejonych płyt można dokonać do 4 minut od przyklejenia do izolowanej powierzchni. W narożnikach zastosować dodatkowo podpory do momentu związania kleju ok. 10 – 15 minut. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. W strefie cokolowej oraz wzdłuż krawędzi budynku

wymagane jest użycie dodatkowych mocowań mechanicznych. Szczeliny i złącza pomiędzy klejonymi płytami wypełnić klejem. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć środkiem do czyszczenia np. czyścik do pian poliuretanowych. Prac z użyciem kleju nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych oraz silnego nasłonecznienia. Nie stosować produktu w przypadku ciągłego narażenia na wodę np. przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej lub wysokiego stanu wód gruntowych.

Mocowane płyty termoizolacyjne powinny mieć proste krawędzie. Podłoża przygotowane do klejenia płyt powinny być płaskie, wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ściany nie może przekraczać  $-4$  mm i  $+2$  mm. Pomiaru odchyień należy dokonywać łatą o długości 2 m, z dokładnością do 1 mm. W przypadku ścian charakteryzujących się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą (szpachlową).

#### PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$  (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Termin ważności 12 miesięcy. Data ważności znajduje się na dnie opakowania.

#### DANE TECHNICZNE

Kolor	Jasno żółty
Temperatura pracy	Od $-5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$
Temperatura puszki	Optymalnie $+20^{\circ}\text{C}$
Czas korekty	Ok 4 min ( $23^{\circ}\text{C}$ , RH 50%)
Czas kółkowania	Po 2 h
Czas pełnego utwardzenia	24 h
Rozpuszczalność (przed utwardzeniem)	Czyścik do pian
Wydajność piany z opakowania 750 ml:	– ETICS: do $8\text{ m}^2$ – przyziemia: do $12\text{ m}^2$
	Wydajność jest uzależniona od temperatury, wilgotności powietrza, sposobu aplikacji, umiejętności montażysty